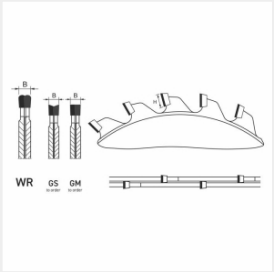
DI316 Podcinaki składane DIA

Promocja



Cechy - korzyści

wysokość płytki z polikryształu diamentu PKD = 6,0 mm - możliwość od 8 do 10 ostrzeń
możliwość wykonania podcinaków na indywidualne zamówienie o średnicach zewnętrznych fi 80 mm oraz fi 100 mm i większych
podcinaki DIA to wysokowydajne narzędzia przemysłowe posiadające syntetyczny diament z ziaren o mikronowej wielkości

Zastosowanie

do podcinania wierzchniej warstwy laminatu, okleiny w tworzywach drewnopochodnych (płyta wiórowa laminowana, surowa, MDF, HDF, LDF, etc.)
piła podcinająca współpracująca z piłą główną na formatyzerkach z możliwością regulacji przekładkami dystansowymi
w przemyśle meblarskim stosowane najczęściej do pracy na formatyzerkach poziomych

Katalog	Index	Średnica zewnętrzna (D)	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	Z Ilość zębów	Geometria zęba	H [mm] Wysokość płytki PKD	J.m.
○	DI316-0125-0004	0125	20	2,8-3,6	12+12	WR 5	6	szt.
○	DI316-0125-0003	0125	22	2,8-3,6	12+12	WR 5	6	szt.

Do pobrania

DaneTech_DI_PL.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Podcinaki stożkowe DIA

Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły tarczowe DIA

Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie

Piły LL MULTI CUT VH do cięcia pojedynczego i pakietowego tworzyw drewnopochodnych